

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
会议时间	2026年6月16日
会议地点	上海市浦东新区新元南路388号
上市公司 接待人员姓名	董事长：HUI WANG 董事、总经理：王坚 副总经理：陈福平 财务负责人：LISA YI LU FENG 董事会秘书：罗明珠
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>● 问答环节</p> <p>1、问：公司今年的订单情况如何？增长趋势及驱动因素有哪些？</p> <p>答：此前公司已披露 2026 年第一季度的新签订单同比增速为 65%，这为公司营收增长奠定了较好基础。按照惯例，公司将在每年 9 月底自愿披露在手订单情况，敬请关注公司后续披露的公告。同时，综合近年来的业务发展趋势，以及目前的订单等多方面情况，公司仍然维持 2026 年全年 82.00 亿元至 88.00 亿元之间的营收预测。</p> <p>2、问：请问在公司的几类主流设备中，订单增长情况如何？</p> <p>答：此前公司已披露 2026 年第一季度的新签订单同比增速为</p>

65%。清洗设备方面，公司高温及中温硫酸设备的工艺已达到国际领先水平，能够有效提升全球客户产品良率。目前，中国及海外客户对该设备均产生较大兴趣，公司预计 2026 年中低温及高温硫酸设备将交付 20 余台设备至多个客户。电镀设备业务也将迎来显著增量，在 2026 年至今的新签订单中，电镀设备占比约 30%。

3、问：公司认为国产半导体设备的天花板在何处？是来自先进封装的新增产能，或者出海机遇？前道与后道设备的发展情况如何？

答：未来，存储及逻辑领域仍将处于建设周期，公司对未来行业发展趋势保持乐观预期，持续看好中国半导体消费市场前景。前道及后道设备方面，后道设备的市场体量还远小于前道设备市场体量，但其增长率快于前道设备。

4、问：公司提到临港 mini-line 产线对设备研发进度助力明显，请介绍一下产线投产的实际效果。

答：公司定向增发的募投项目临港 mini-line 的建设取得积极进展，这是一条在 100 级洁净室环境下运行的完整实验性研发产线，整合了盛美自研设备、第三方工艺设备以及量测设备，能够在接近客户端真实量产环境的条件下开展工艺验证与联合研发。临港 mini-line 带来的不只是研发效率的提升，更重要的是推动了公司新产品开发与交付模式的升级。过去，新设备通常需要直接进入客户端开展较长周期的验证与工艺调试；而现在，公司可以先在临港 mini-line 上基于客户产品需求进行工艺验证与参数优化，出货前就完成针对客户特定工艺需求的预验证，在满足客户特定工艺要求后，才交付客户端进行最终验证，大大加快了设备在客户端的验证周期。

该内部工艺线可覆盖清洗、电镀、涂胶显影、炉管及 PECVD 等全

品类设备流片验证，降低外协测试成本，同时能够提前模拟各类制程工况，有助于优化设备稳定性与颗粒控制指标，还可配合客户开展下一代工艺联合开发。目前，这一模式已经展现出积极成效。公司4月出机的首台 PECVD SiCN 设备，正是在临港完成工艺预验证后出机，直接进入客户端最终验证阶段，显著缩短了客户端验证周期。此外，公司高温单片 SPM 产品也在临港与主要客户完成了数月联合测试及工艺参数优化。在完成 15 纳米颗粒控制性能验证后，该产品已成功获得多家客户批量订单。这些案例充分体现了临港 mini-line 在加速新产品开发、工艺验证及客户导入方面的重要战略价值。

5、问：请问国内电镀设备的市场空间多大？

答：从市场规模长期来看，3D 封装会大规模应用电镀设备，头部封测企业后续集中采购规模可达数百台，落地周期暂未确定，但长期需求确定性较强；中国台湾地区头部晶圆代工厂年采购量也有一百多台，行业整体规模可观。国内市场尚处起步阶段，未来成长潜力突出，今年公司电镀设备业务也将迎来显著增量。

6、问：请问公司电镀设备毛利率表现如何？

答：现阶段公司世界首创的新产品 ECP 面板级电镀设备，创新性地采用了专利申请保护的水平式面板电镀方式，让方形电场与方形硅片实现同步旋转，能够更好地控制电镀均匀性；同时能够实现硅片传输过程中引起的槽体间污染控制，大大降低了不同种类金属电镀槽之间化学交叉污染的风险，依托该设备的技术难度及市场稀缺性，其毛利率表现良好。

7、问：公司 PECVD 设备当前开发进展如何？

答：今年4月，公司首台 PECVD SiCN 设备已经顺利出机，该设备在盛美上海临港实验室已验证满足工艺指标，现发往客户端进

行最终验证。该平台在单一反应腔内配置了三个工艺工位（专利申请保护中），采用旋转沉积的方式，每个工位完成总膜厚三分之一的沉积。这种设计能够实现对界面层形成、气流管理及薄膜均匀性的更精确控制。此外，盛美“一工位一射频”控制软件技术，通过每个工位独立的射频系统实现对等离子体的独立控制，大幅提升工艺的稳定性与一致性。该设备旨在支持 55 纳米及以下高端 IC 工艺的后段金属互联工艺应用中的 PECVD NDC (SiCN) 工艺，应用场景包括铜氧化抑制、铜扩散阻挡层及刻蚀停止层。

8、问：能否详细介绍一下炉管和 PECVD 这两个设备的订单情况？

答：公司 LPCVD、ALD 炉管系列设备持续推进技术研发，均取得了创新突破。炉管设备方面，公司已获取部分客户的重复订单，此外，公司还自主研发了高温 Ultra Fn 立式炉管设备，该设备采用公司独有的立式炉管结构设计，具备最高 1250° C 的处理能力，能够聚焦高端 IGBT 应用，市场整体反响良好。ALD 设备方面，公司已积累了一系列自主研发的具有全球知识产权保护的专利技术，以差异化创新工艺持续满足客户多样化需求；PECVD 方面，公司正在与两家客户进行积极洽谈。

9、问：公司面板级封装设备在中国台湾市场的进展情况如何？

答：目前，公司重点推出的世界首创面板级先进封装的新设备包括 Ultra ECP ap-p 面板级电镀设备、Ultra C vac-p 面板级负压清洗设备和 Ultra C bev-p 面板级边缘刻蚀设备等三款新产品。其中，Ultra ECP ap-p 面板级电镀设备创新性地采用了专利申请保护的水平式面板电镀方式，让方形电场与面板实现同步旋转，能够更好地控制电镀均匀性；同时能够实现面板传输过程中引起的槽体间污染控制，大大降低了不同种金属电镀槽之间化学交叉污染的风险；Ultra C vac-p 面板级负压清洗设备利用负压技术去除微凸块中的助焊剂残留物，可使清洗液到达狭窄的缝

隙，显著提高了清洗效率，目前该设备已经在客户端实现量产；Ultra C bev-p 面板级边缘刻蚀设备采用专为边缘刻蚀和铜残留清除而设计的湿法刻蚀工艺，在扇出型面板级封装技术中起到至关重要的作用。

公司将积极推进上述三类产品在中国大陆和台湾市场、新加坡、韩国市场的应用及拓展，后续相关产品的具体动态信息敬请关注公司披露的公开信息。公司将积极把握面板级设备市场发展趋势，做全湿法工艺的面板设备类型。

10、问：请问公司涂胶显影设备取得的具体成效如何？

答：公司布局前道涂胶显影多年，在涂胶显影设备（Track）领域，公司正有序推进 KrF 与 ArF 两大技术节点的产品布局，这两款设备亦是公司 Track 系列的核心组成部分。经过 5 年的潜心研发，2025 年第三季度公司推出首款自主研发的高产出（300WPH）KrF 工艺前道涂胶显影（Track）设备 Ultra LITH KrF，该产品具有高产能、先进温控技术以及实时工艺控制和监测功能，进一步拓展了光刻相关的应用领域，展现了公司在新产品品类中的持续扩展能力，已于 2025 年 9 月顺利交付中国头部逻辑晶圆厂客户，预计今年 7 月份与光刻机对接，年底完成全生产流程验证。同时，基于 KrF 与 ArF-i 设备在功能上的共同性，公司有望加快推进 ArF-i 设备的生产及研发进程，并期待未来与客户端的紧密合作。

11、问：未来公司海外市场的营收的目标是多少？

答：公司的长期营收目标是 40 亿美元，其中海外地区的长期营收目标为 16 亿美元，中国大陆市场的长期营收目标为 24 亿美元。

12、问：请公司能否介绍一下韩国团队的情况公司海外产能后续

规划？

答：公司持续推进海外业务布局，韩国业务目前运营成熟。除韩国之外，盛美上海也在寻求新加坡、马来西亚、越南、泰国等东南亚市场的更多市场机会。

13、问：请问公司厂房 B 投产后，未来产能情况如何？

答：公司当前 A 厂房已接近满产，B 厂房计划于今年下半年启动装修，四季度力争实现部分产线投产。A、B 厂房全部投产后整体年产值可达 200 亿元，B 厂房投产后将进一步打开公司业绩成长空间。

14、问：长远看半导体零部件涨价趋势，请问公司库存大概是什么样的情况？

答：公司已关注到零部件市场的价格波动情况，采取了相应的应对措施。目前，公司通过提高本土零部件使用比例、推进供应渠道多元化布局、提前储备零部件库存等多种方式降低市场价格波动对公司的影响。近年来，公司的核心零部件本土化进程也已取得积极进展。目前非标准件已实现全面本土化；对于标准件中的部分核心零部件同样取得了重要突破，例如磁旋泵、加热器、过滤器等部分实现本土化。同时，为系统推进公司零部件本土化，公司从 2025 年开始，在半导体前道及先进封装领域先后设计并组装出两台全部使用本土零部件的设备（需要特别说明的是，上述设备仅为公司内部用于检验零部件性能的测试设备），之后计划将其在临港洁净室中进行零部件测试及验证，并将把通过验证的合格零部件逐步导入公司量产设备中。

附：参与单位名称

Anatole Investment
Arrowpoint
Balyasny Asset Management
CloudAlpha
CPE 源峰
Goldstream Capital
Greenwoods
IDG 资本
Oasis
WFM Asia
爱建证券有限责任公司
北大方正人寿保险有限公司
北京富弘荣宸私募基金管理有限公司
北京泰致投资有限公司
北京源乐晟资产管理有限公司
壁仞投资
博睿资本
博时基金管理有限公司
财通基金管理有限公司
财信基金管理有限公司
常州金融投资集团有限公司
承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）
第一上海投资有限公司
鼎森集团有限公司
东方证券股份有限公司
东吴人寿保险股份有限公司
方正证券股份有限公司
复星联合健康保险
富安达基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
高瓴集团
广州芯晟投资有限公司
国海证券有限责任公司
国联民生证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司
国泰海通政策产业研究院
国泰基金管理有限公司
海创（上海）私募基金管理有限公司
杭州济海投资有限公司
杭州弈宸私募基金管理有限公司
杭州涨不停企业管理咨询有限公司
苏州红方红投资管理有限公司

鸿商资本股权投资有限公司
华创资管
华福证券股份有限公司
华鲁投资发展有限公司
华能贵诚信托有限公司
华数数科（浙江）股权投资有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
华泰资产管理有限公司
华夏基金管理有限公司
华兴证券有限公司
辉腾投资
汇安基金管理有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司
惠理基金
嘉实基金管理有限公司
建信保险资产管理有限公司
江苏毅达股权投资基金管理有限公司
九方智投控股有限公司
兰馨亚洲投资集团
民生加银基金管理有限公司
摩根大通集团
南方基金管理股份有限公司
南京祥运和投资管理有限公司
南京证券股份有限公司
宁波和济投资
鹏华基金管理有限公司
瑞银集团
厦门国际银行上海分行
山西证券股份有限公司
上海道仁资产管理有限公司
上海道子天资产管理有限公司
上海国投科创产业研究院
上海国有资本投资有限公司
上海鹤禧私募基金管理有限公司
上海景林资产管理有限公司
上海朗程投资管理有限公司
上海量泽投资管理有限公司
上海聆泽私募基金管理有限公司
上海明投资管理有限公司
上海荣疆投资管理有限公司
上海森锦投资管理有限公司
上海尚颀投资管理合伙企业
上海韦豪创芯投资管理有限公司

上海小熙投资管理有限公司
上海驭秉投资管理有限公司
上海远海私募基金管理有限公司
上海兆顺私募基金管理有限公司
上海证券通投资资讯科技有限公司
上海证券有限责任公司
上海紫阁投资管理有限公司
申万宏源证券有限公司
深圳市前海尚善资产管理有限公司
深圳市协众投资管理有限公司
太保资产
太平基金管理有限公司
天风证券股份有限公司
天瑞万合（上海）私募基金管理有限公司
天演论集团
伟星资本
西部利得基金管理有限公司
西部证券股份有限公司
西南证券股份有限公司
新华资产管理股份有限公司
鑫元基金管理有限公司
信达澳亚基金管理有限公司
信庭投资国际有限公司
兴证全球基金管理有限公司
宜兴科产谷产业基金合伙企业
永赢基金管理有限公司
远信（珠海）私募基金管理有限公司
云南国际信托有限公司
泽安私募基金管理（三亚）合伙企业（有限合伙）
长江证券股份有限公司
长信基金管理有限责任公司
招商基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
浙江吉晟资产管理有限公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中财招商投资集团商业保理有限公司
中电科投资控股有限公司
中庚基金管理有限公司
中国电子专用设备工业协会半导体设备分会
中国光晖投资控股公司
中国国际金融股份有限公司
中海基金管理有限公司
中泰证券股份有限公司

中信证券股份有限公司
中证鹏元资信评估股份有限公司
个人投资者